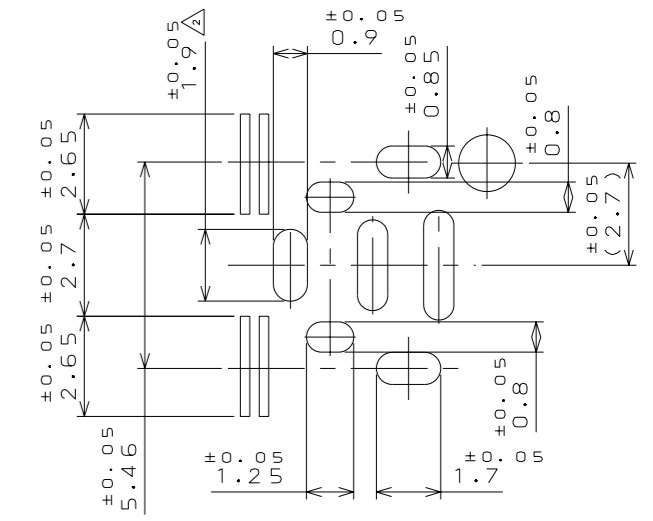
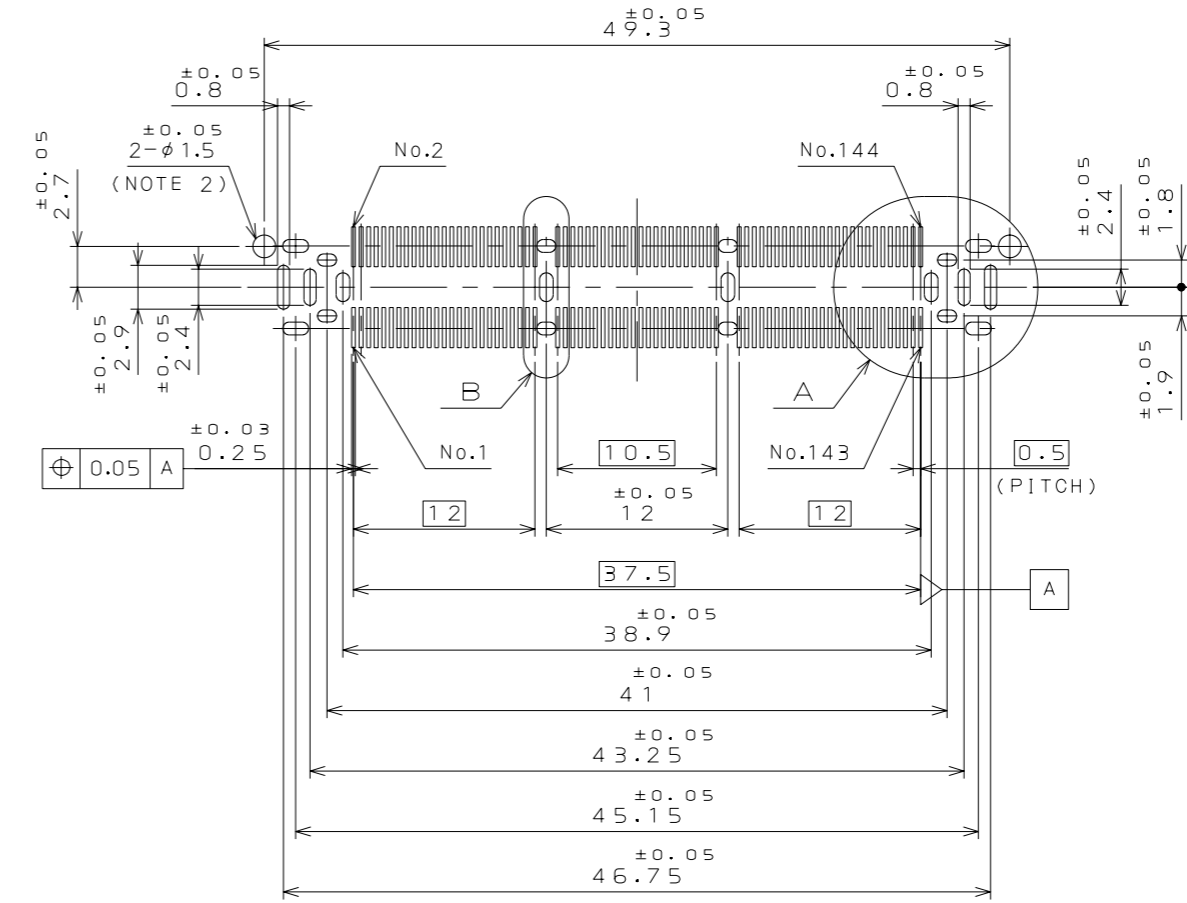
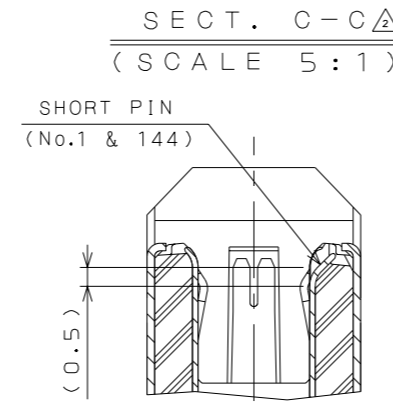
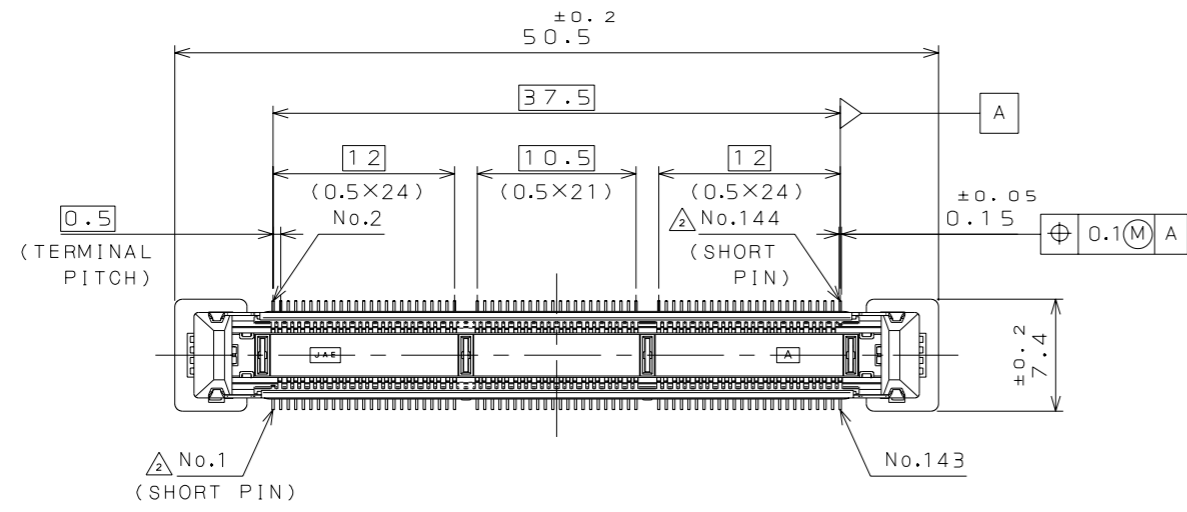
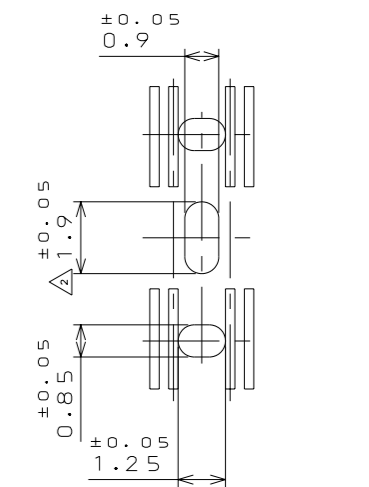


REFERENCE ONLY
JAE

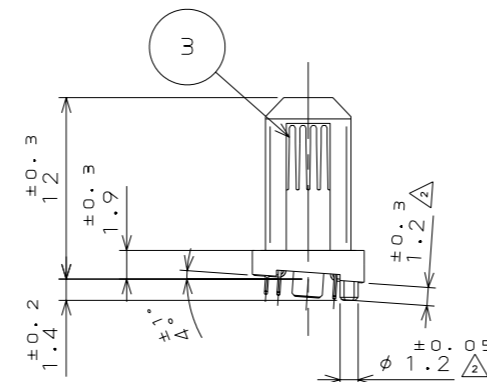
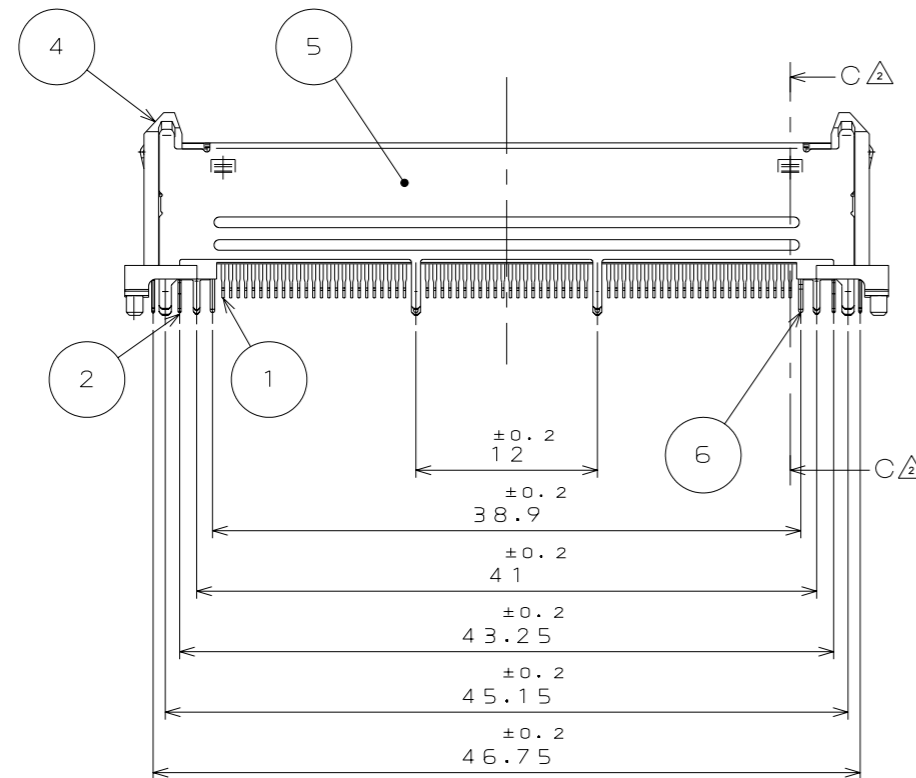
版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	28.Jan.2008	064913	REVISED DIMENSION		M.SASAKI		K.HISATOMI



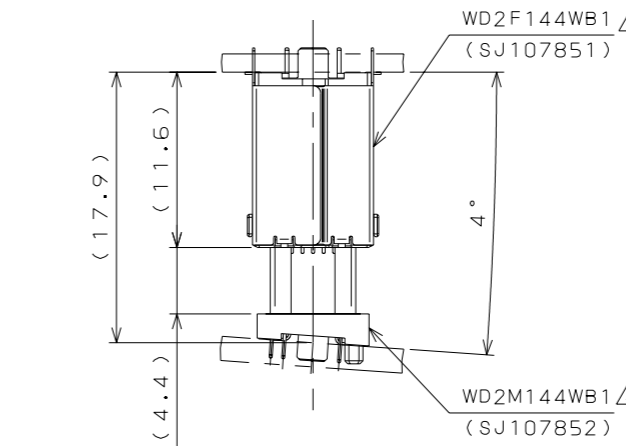
DETAIL A
(SCALE 5:1)



DETAIL B
(SCALE 5:1)



APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
適合基板寸法 (参考)



MATED CONDITION (REF.)
嵌合状態図 (参考)

TABLE 1

	SIGNAL CONTACT 信号コンタクト	POWER CONTACT #1 & #2 電源コンタクト #1 & #2
CONTACT AREA 接触部	GOLD (0.3μm MIN.) OVER NICKEL Ni上Au 0.3μm以上	GOLD (0.3μm MIN.) OVER NICKEL Ni上Au 0.3μm以上
SOLDERING AREA 半田付部	GOLD FLASH OVER NICKEL Ni上Auフラッシュ	TIN PLATING OVER NICKEL Ni上Sn

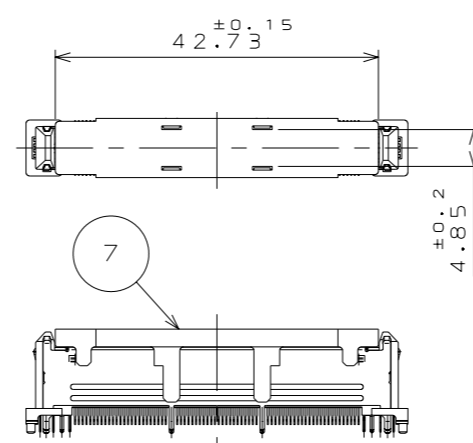
△	NO.	DESCRIPTION	QTY.	MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
	7	CAP	1	GLASS FILLED PPS		
	6	HOLD PIN	4	COPPER ALLOY	TIN PLATING	
	5	SHELL	2	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
	4	INSULATOR	1	GLASS FILLED LCP		UL94V-0 COLOR:BLACK
	3	POWER CONTACT #2	2	COPPER ALLOY	TABLE 1	
	2	POWER CONTACT #1	2	COPPER ALLOY	TABLE 1	
	1	SIGNAL CONTACT	144	COPPER ALLOY	TABLE 1	

NOTE 1. TERMINAL COPLANARITY IS 0.1mmMAX.

NOTE 2. ALL HOLES, EXCEPT FOR 1.5mm DIA. HOLES AS SHOWN, NEED TO BE THROUGH-HOLE PLATING.

注1. 端子平坦度は0.1mm以下

注2. 図示の穴(φ1.5)以外の穴は、スルーホールめっきを施すこと。



CAP ASSEMBLED CONDITION
キャップ組込み状態図

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)					
第1版 (ORIGINAL DATE)			12.JUL.2007		尺度 (SCALE) 2:1
製図 DR.			M.SASAKI		シリーズ (SERIES) WD2
担当 CHK.			M.SASAKI		名称 (TITLE) WD2M144WB1
査閲 APPD.					
承認 APPD.			K.HISATOMI		
公差 (GENERAL TOLERANCE)					
寸法 (DIMENSION)		角度 (ANGLES)			
. ±0.8		×° ±			
.X ±0.4		×°X ±			
.XX ±0.1					
.XXX ±					
質量 (MASS)					

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION
ELECTRONICS
INDUSTRY, LTD.
図面番号 (DRAWING NO.) SJ107852
版数 (REV.) 2